## 器件的结构

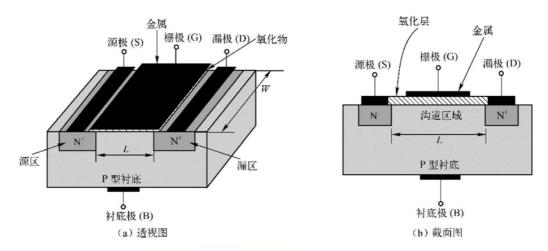
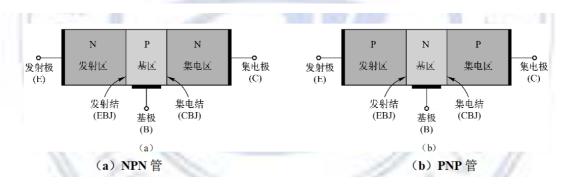


图 1 N沟道 EMOS 的物理结构



不同的物理结构决定了器件在等效电路中的表现形式,MOS 管一般可以看作 VCCS ,而 BJT 则是一般看作 CCCS 。

可以发现,它们的控制量不同,但是受到影响的都是电流量,而这个电流量可以通过添加负载的形式转化为电压量。

## 器件特性

这部分仅比较器件本身的参数特性异同。

#### MOS 的特性

MOS 是四端元器件,一般来说有三个工作状态:**截止区、变阻区、饱和区**。

且在 MOS 器件中,器件本身没有固定**源极**和**漏极**,当且仅当器件接入电路后根据电路工作的电势关系确定后才能确定其源极和漏极。

- 截止区:截止区的 MOS 器件的源极到漏极几乎没有电流,此时在源极和漏极之间没有形成沟道。
- 变阻区:变阻区的 MOS 器件的源极和漏极间出现反形层,在器件内部有漏极到源极的漂移电流:

$$i_D = k_n' rac{W}{L} [(v_{_{GS}} - V_t) v_{_{DS}} - rac{1}{2} v_{_{DS}}^2]$$

• 饱和区:饱和区的 MOS 器件的反形层在  $v_{\scriptscriptstyle DS}$  的作用下逐渐消失,此时的工作电流几乎与  $v_{\scriptscriptstyle DS}$  无关:

$$i_{\scriptscriptstyle D} = k_n^\prime rac{W}{2L} (v_{\scriptscriptstyle GS} - V_t)^2$$

若考虑沟道长度调制效应,则有 $i_{\scriptscriptstyle D}^\prime=i_{\scriptscriptstyle D}(1+\lambda v_{\scriptscriptstyle DS})$ 

• 沟道长度调制效应: 等效出的理想受控源会并联上一个输出电阻:

$$egin{aligned} r_o &= [rac{\partial i_{_D}}{\partial v_{_{DS}}}]^{-1} \ &= [\lambda k_n^\prime rac{W}{2L} (v_{_{GS}} - v_t)^2]^{-1} \ &= rac{V_{_A}}{I_{_D}} = rac{1}{\lambda I_{_D}} \end{aligned}$$

• 跨导: 等效出的 *VCCS* 的系数:

$$g_m \equiv rac{i_{_d}}{v_{_{gs}}} = k_n^\prime rac{W}{L} (V_{_{GS}} - V_{_t}) = \sqrt{2 I_{_D} k_n^\prime rac{W}{L}} = rac{2 I_{_D}}{V_{_{OV}}}$$

在推导这串等式中需要注意:  $i_D = I_D + i_d$ 

$$egin{aligned} i_{_D} &= k_{_n}' rac{W}{2L} (V_{_{GS}} + v_{_{gs}} - V_{_t})^2 \ &= k_{_n}' rac{W}{2L} [(V_{_{GS}} - V_{_t})^2 + 2 v_{_{gs}} (V_{_{GS}} - V_{_t}) + v_{_{gs}}^2] \end{aligned}$$

旦有:

$$v_{\scriptscriptstyle qs} \ll 2(V_{\scriptscriptstyle GS}-V_t)$$

即:

$$egin{align} i_{\scriptscriptstyle D} &= rac{1}{2} k_n^\prime rac{W}{L} [(V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle t})^2 + 2(V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle t}) v_{\scriptscriptstyle gs}] \ &\Rightarrow I_{\scriptscriptstyle D} &= rac{1}{2} k_n^\prime rac{W}{L} (V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle t})^2 \ &i_{\scriptscriptstyle d} &= k_n^\prime rac{W}{L} (V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle t}) v_{\scriptscriptstyle gs} \ \end{array}$$

#### BJT 的特性

BJT 是三端元器件,一般来说有四个工作区:**饱和区、放大区、截止区、击穿区**。

晶体三极管结构并不对称,从左到右的导体区本别为:**发射区、基区、集电区**,分别对应:**发射极** (E)、**基极**(B),**集电极**(C),其中形成的两个PN结分别为:**发射结**(EBJ)、**集电结**(CBJ)。

其必须满足的工艺条件:

- 发射区为高掺杂, 保证发射足够多的自由电子;
- 基区很薄,以减小基区中非平衡少子(自由电子)在向集电结扩散过程中复合,保证绝大部分的非平衡少子都能到达集电结边界处;
- 集电结的面积远远大于发射结的面积,保证扩散到集电结边界处的非平衡少子全部漂移到集电区,形成受控的集电极电流。
- 饱和区:两个 PN 结均正偏,这个区域内的  $i_{\scriptscriptstyle C}$  与  $i_{\scriptscriptstyle B}$  不满足电流传输方程,且近似认为集电极电压为 0.3V,即三极管饱和压降为  $V_{\scriptscriptstyle CE(sat)}=0.3V$ 。
- 放大区: 发射结正偏,集电结反偏截止,此时有 $V_{\scriptscriptstyle CE}>0.3V$   $V_{\scriptscriptstyle BE}=0.7V$ 。
- 截止区:发射区电流  $I_{\scriptscriptstyle E}=0$  以下的区域称为截止区,即发射结和集电结均反偏。当  $i_{\scriptscriptstyle E}=0$  时,有  $i_{\scriptscriptstyle C}=-i_{\scriptscriptstyle B}=I_{\scriptscriptstyle CBO}$ 。
- 击穿区: 集电结上反偏电压过大, 导致 $i_c$  剧增, 形成击穿区。
- 基区宽度调制效应: 等效出的理想受控源会并联上一个输出电阻:

$$egin{align} r_{_o} &\equiv [rac{\partial i_{_C}}{\partial v_{_{CE}}}]^{-1} \qquad i_{_C} = I_{_S} e^{v_{_{BE}}/V_{_T}} [1 + rac{v_{_{CE}}}{V_{_A}}] \ &\Rightarrow r_{_o} = rac{V_{_A}}{I_{_C}} \end{split}$$

• 放大参数:

o 
$$\overline{lpha}pproxrac{I_{_C}}{I_{_E}}$$
 o  $\overline{eta}pproxrac{I_{_C}}{I_{_B}}$   $lpha=rac{\Delta i_{_C}}{\Delta i_{_E}}\Big|_{_Q}$  o  $eta=rac{\Delta i_{_C}}{\Delta i_{_B}}\Big|_{_Q}$ 

• 跨导:如果等效为 VCCS,则有

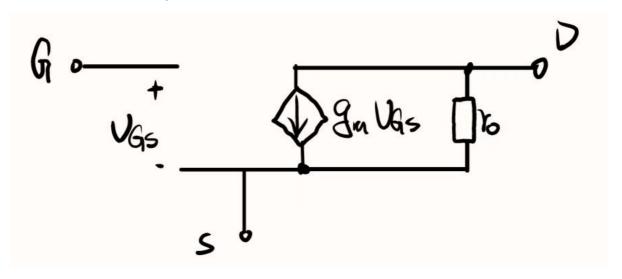
$$egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} egi$$

# 器件建模

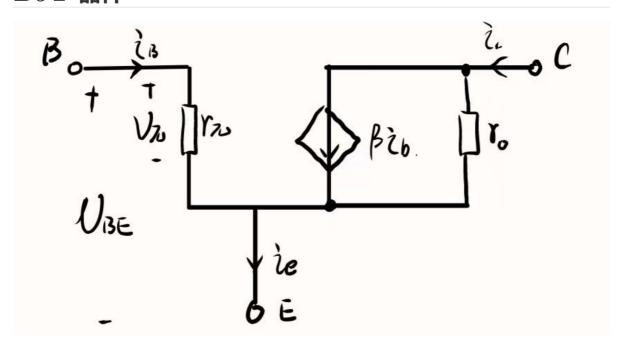
该部分只给出器件的等效模型

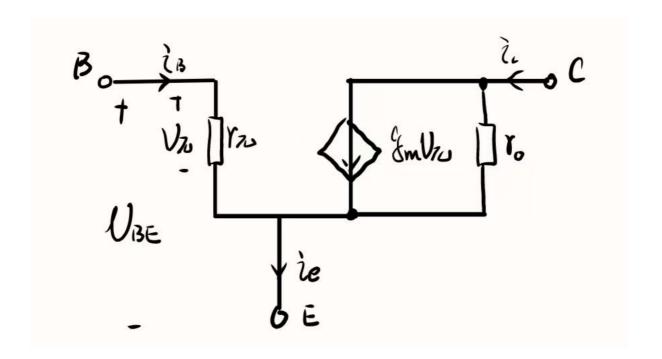
## MOS 器件

考虑沟道长度调制效应, $r_{o}$ 是一个极大的电阻,对粗略估算没有太大影响。



### BJT 器件





## 放大器应用

根据器件接入的不同公共极,其作用可以大致分为: 放大、电流跟随、电压跟随。

- 放大器: 在MOS中,采用CS电路;在BJT中则采用CE电路。
  - $\circ$  MOS 器件的参数特性:

$$R_{_i}=rac{v_{_i}}{i_{_i}}=R_{_G} \qquad R_{_o}=rac{v_{_t}}{i_{_t}}=r_{_o}//R_{_D}//R_{_L} \ A_{_V}=-g_{_m}(r_{_o}//R_{_D}//R_{_L})$$

- 一般  $R_G$  会采用大电阻以提高源电压增益;若加入源极电阻  $R_S$ ,既可以选取合适的阻值来控制  $v_{GS}$ ,以避免某些不必要的非线性失真。
- $\circ$  BJT 器件的参数特性:

$$egin{aligned} R_{_i} &= R_{_B}//r_{_\pi} \quad R_{_o} = r_{_o}//R_{_C} \ A_{_V} &= -g_{_m}(r_{_o}//R_{_D}//R_{_L}) \end{aligned}$$

- 电流跟随器: 在MOS中,采用CG电路;在BJT中则采用CB电路。
  - $\circ$  MOS 器件的参数特件:

$$egin{aligned} R_i = rac{v_i}{i_i} = rac{-v_{_{GS}}}{-g_{_m}v_{_{GS}}} = rac{1}{g_{_m}} & R_o = rac{V_{_t}}{i_{_t}} = R_{_D} \ A_{_V} = rac{v_{_o}}{v_{_i}} = g_{_m}(R_{_D}//R_{_L}) \end{aligned}$$

- $\blacksquare$  该输入电阻的数量级为欧姆,但是在考虑源电压增益时会丢失大量信号,但是考虑电流增益会发现 $A_i=rac{R_D}{R_D+R_L}$ ,对于足够大的输出电阻则有  $A_ipprox 1$ 。
- ∘ BJT 器件的参数特性:

$$egin{aligned} R_{_i} &= rac{V_{_i}}{i_{_i}} = rac{r_{_\pi}}{1+eta} = r_{_e} \quad R_{_O} = R_{_C} \ A_v &= g_{_m}(R_{_C}//R_{_L}) \quad A_i = lpha rac{R_{_C}}{R_{_C}+R_{_L}} \end{aligned}$$

- 电压跟随器: 在MOS中,采用CD电路;在BJT中则采用CC电路。
  - *MOS* 器件的参数特性:

$$egin{aligned} R_i = rac{v_i}{i_i} = R_{\scriptscriptstyle G} & R_o' = rac{V_{\scriptscriptstyle t}}{i_{\scriptscriptstyle t}'} = rac{1}{g_{\scriptscriptstyle m}} & R_{\scriptscriptstyle o} = r_{\scriptscriptstyle o}//rac{1}{g_{\scriptscriptstyle m}} pprox rac{1}{g_{\scriptscriptstyle m}} \ A_{\scriptscriptstyle V} = rac{v_{\scriptscriptstyle o}}{v_{\scriptscriptstyle i}} = rac{r_{\scriptscriptstyle o}//R_{\scriptscriptstyle L}}{r_{\scriptscriptstyle o}//R_{\scriptscriptstyle L} + rac{1}{g_{\scriptscriptstyle m}}} \end{aligned}$$

- 该输入电阻非常大,可作为多级放大器的输出极使用。
- ∘ BJT 器件的参数特性:

$$egin{align} R_{_{i}} &= R_{_{B}}//R_{_{ib}} & R_{_{ib}} = (1+eta)[r_{_{e}} + (r_{_{o}}//R_{_{L}})] \ R_{_{o}} &= r_{_{o}}//R_{_{o}}' & R_{_{o}}' = rac{r_{_{\pi}} + R_{_{sig}}//R_{_{B}}}{1+eta} \ A_{_{V}} &= rac{(1+eta)(r_{_{o}}//R_{_{L}})}{r_{_{\pi}} + (1+eta)(r_{_{o}}//R_{_{L}})} pprox 1 \end{split}$$